

奥特斯出席IPC 2024中国电子制造年会

上海2024年10月25日 /美通社/ -- 奥特斯于2024年10月25日出席IPC 2024中国电子制造年会，并在两大论坛：IC载板及PCB论坛和未来工厂论坛，发表演讲。奥特斯电子解决方案业务部(BU ES)资深质量总监黄建明 (Tony Huang) 及奥特斯微电子业务部(BU ME)资深质量总监林涛 (Mortran Lin) 分享他们在半导体封装和现代化质量管理领域的深刻见解。

在未来工厂论坛上，黄建明以《未来质量管理的进化：智能制造中的实践与探索》为题，深入剖析了PCB行业质量管理的痛点，并探讨了任何通过数字化转型技术逐步拓展质量管理的边界。他强调，通过这些技术可以提升产品质量、运营效率及客户满意度，从而增强企业的核心竞争力。此外，他还展示了奥特斯在数字化转型的浪潮中取得的实践成果，并深入探讨了质量管理与数字化结合在企业风险管理、质量健康度以及数字化质量管理自治等方面的潜在可能性。

林涛在IC载板及PCB论坛上发表《基于大数据模型的翘曲度控制》主题演讲，深入探讨半导体封装载板生产过程中的技术挑战。他指出，随着芯片技术的不断进步，芯片的运算能力得到了显著提升，这对信号传输速度和互联技术提出了更高要求。封装载板尺寸的扩大和连接点密度的增加，尤其是使用不同热膨胀系数材料的组合，使得翘曲度控制成为确保封装可靠性的关键。奥特斯独有的质量控制预测模型能够有效帮助客户解决翘曲度控制的难题，助力客户提升产品竞争优势。

作为全球领先的高端印刷电路板及半导体封装载板制造商，奥特斯专注于为5G、物联网、自动驾驶、数据中心及医疗等高科技领域提供创新的电子解决方案。奥特斯的产品覆盖从高密度互连印制电路板到先进的半导体封装载板，致力于为客户提供卓越的信号传输性能及可靠性，支持未来的科技发展。

奥特斯全球高级副总裁兼中国区董事会主席朱津平对此评论道："我们非常荣幸能够在IPC CEMAC 2024分享我们的技术与经验。奥特斯一直致力于推动行业创新，同时保持最严格的质量标准，以应对全球电子制造业的快速发展。"

奥特斯在中国拥有两大核心生产基地，分别位于重庆和上海。这两座工厂不仅是奥特斯全球制造网络的重要组成部分，也是公司推动创新和技术领先的关键力量。

奥特斯重庆工厂主要生产先进的半导体封装载板和模组产品，支持5G、人工智能、物联网等领域的快速发展。凭借全球领先的生产设备和技术，重庆基地的封装载板为复杂的芯片设计和更高的信号传输速度提供坚实的基础，广泛应用于高性能计算、服务器、人工智能、物联网和数据中心。

奥特斯上海工厂则专注于高密度印制电路板 (HDI) 的制造，尤其是在移动设备和汽车电子市场上有着显著的优势。该基地不仅拥有高自动化生产线，还利用大数据技术进行智能化管理，确保产品的高精度和高可靠性。通过为全球客户提供高质量的HDI产品，上海工厂持续推动电子制造的现代化进程。

奥地利科技与系统技术股份有限公司 – 先进技术和解决方案

奥地利科技与系统技术股份公司简称奥特斯，是欧洲以及全球领先的半导体封装载板和高端印制电路板制造商。集团致力于生产具有前瞻性技术的产品，并将工业领域的核心市场定位于：半导体封装载板、移动设备、汽车与航空航天、工业和医疗。作为一家飞速发展的跨国公司，奥特斯分别在奥地利（莱奥本、菲岭）、印度（南燕古德）、中国（上海、重庆）和韩国（安山，首尔附近）拥有生产基地。目前，奥特斯正在马来西亚居林新建一座高端半导体封装载板生产基地，同时在莱奥本，奥特斯正在打造涵盖量产在内的欧洲技术中心。公司拥有约13,500多名员工。更多资讯，请浏览公司网站 www.ats.net。

原文地址：http://www.china-nengyuan.com/exhibition/exhibition_news_216824.html